

# 红外返修台 T862++



1/8









### 862++的操作方法

无铅的板子，设定预热温度为200度，在拆焊的芯片四周，刷上助焊剂，再预热3-5分钟；调节灯体温度到350，调节灯体镜头距离线路板20-25mm，再开启顶部红外灯，60-120s后，会拆焊成功的

关键点：底盘预热温度：200；调节灯体温度到350；调节灯体镜头距离线路板20-25mm。

预热3-5分钟

预热3-5分钟，让板子达到140度以上

不能用焊丝啊，用助焊剂

## 產品特點:

- 採用自主研发的紅外線拆焊技術。
- 專用紅外線加熱，穿透力強,器件受熱均勻,突破傳統熱風拆焊機罩住元件加熱，熱衝擊較大缺點。
- 操作容易，經過一天訓練即可完全操作本機。
- 無需拆焊治具，本機可拆焊 **15x15-35x35mm** 所有元件。
- 本機配備 **650W** 預熱溶膠系統，預熱範圍 **120x120mm**。
- 紅外線加熱無熱風流動，不會影響周邊微小元件，可拆焊或返修 **BGA、SMD、CSP、LGA、QFP、PLCC** 和 **BGA** 植球，尤其是返修 **BGA** 元件。
- **T-862++**完全能滿足手機、筆記本、電腦、電遊等 **BGA** 維修要求。

## 產品參數：

電源電壓:**AC220V 50Hz**; (**AC110V 60Hz** 需單獨定做)；

額定功率:**800w**;

預設溫度:**100℃-350℃**;

發熱元件:紅外線光源.

## 裝機步驟：

1. 裝入導柱。首先放鬆調焦架緊固螺母，再按箭頭指示方向插入導柱。
2. 裝定位環。放鬆定位環緊固螺母，再按箭頭指示方向裝入定位環，裝入後旋轉定位環緊固螺母使其固定在相應高度。
3. 整體裝配。①放鬆調焦架緊固螺母。②拿起調焦支架，使導柱對準底盤相應螺母，旋轉導柱。③旋轉調焦架緊固螺母使調焦架固定。
4. 連接紅外燈體連接線。①將連接線插頭對準插入紅外燈連接線插座。②向右旋轉固定螺絲。

## 使用方法:

### 1、開機：

- ①、檢查燈體及電源線是否連接好。
- ②、打開電源開關。等自檢通過後再使用（面板顯示幕上顯示為上次使用時設定值）。
- ③、前面板三個開關，分別控制預熱熔膠盤、燈體和無鉛 **936** 電烙鐵工作。
- ④、按動溫度調節按鈕，可以調節各視窗的設定值，∧升高，∨減小設定值，按後自動存儲到機器裡。下次開機顯示當前值。

### 2、拆焊：

- ①、線路板的放置和燈體高度的調節：

將線路板固定在線路板支架上，調節定位環及調焦架旋鈕，使晶片垂直對準燈體的焦斑；調整燈體高度，保持燈頭與拆焊物件高度為 **20-30mm** 為宜。

- ②、預熱盤的溫度設置：

一般的拆焊無鉛焊接的晶片、大於 **30x30mm** 和塗有防水固封膠的晶片，一定要先給線路板進行預熱熔膠。一般預熱溫度設定：有鉛焊接的板子，設定預熱溫度 **120-140** 度；無鉛的線路板設定預熱溫度 **160-200** 度，（這是預熱盤的溫度）。

開啟預熱底盤，使顯示溫度穩定在設定值左右 **3-5** 分鐘，再開啟紅外燈加熱晶片，才能保證除膠和預熱的要求，拆焊才會成功。

- ③、調節燈體溫度峰值：

根據拆焊晶片大小，適當調節燈體輸出溫度峰值，溫度峰值由 **100-350°C** 可調；折小於 **15x15mm** 晶片時，可調節到 **160-240°C** 左右，折 **15x15mm-30x30mm** 時，可調節溫度峰值到 **240-320°C**，折大於 **30x30mm** 晶片時調到 **350°C**，此時燈體保持直射，此時紅外線光最強（請注意自我控制時間，防止晶片過熱燒壞）。注意：溫度峰值低於 **248°C** 以下時，燈光會間斷閃耀，斷續加熱。

④、不同燈頭的選取。燈體最小光斑直徑為 **15mm**，最大可調焦斑直徑 **50mm**，視不同晶片而定。使用時，根據晶片大小，選取不同的燈頭。備有直徑 **Φ28、Φ38、Φ48** 的三個燈頭，分別滿足小於 **15x15mm、15x15-30x30mm** 和大於 **30x30mm** 的晶片拆焊需求。更換燈頭後，可根據晶片大小，調節調焦旋鈕。使光斑全罩住晶片為宜。

⑤、拆焊晶片前，先在晶片底部或側面注入少量助焊劑，可以得到完好的錫珠，同時可以保護好焊盤，使拆焊過程更流暢。

⑥、過適宜時間後，錫點熔化，取出晶片。一般拆小於 **15x15mm** 以下的，**20-40s** 左右；折 **15x15mm-30x30mm**，**30-60s** 左右；大於 **30x30mm** 晶片，**60-90s** 左右；

### 3、回焊：

①、清潔焊盤：用機器自帶的 **936** 快速烙鐵配合吸錫線、助焊劑，清理好焊盤。塗一點液體助焊劑備用。

②、先將植好錫球或刮好錫漿的 **BGA** 晶片，按對位元要求輕輕放在已清理好的焊盤上。再將線路板固定在線路板支架上，調節支架，使晶片垂直對準燈體的焦斑；然後調整燈體高度，保持燈頭與拆焊物件高度為 **20-30mm** 為宜。

③、開啟預熱盤開關，預熱，等到達到預熱溫度後（此時助焊劑已經開始浸潤焊盤還原焊盤氧化物），快速開啟頂部加熱燈，等助焊劑揮發後，晶片塌落 **10** 秒內關掉頂部和預熱盤，等板子冷卻到 **100** 度以下後，將板子取走，放一旁冷卻。

④、將焊好已冷卻的板子，用洗板液清洗並乾燥後，可以通電測試。如果測試通不過，先查找原因，明確原因後再搞，防止多次焊接損毀板子。

⑤、**936** 快速無鉛烙鐵使用：打開電源開關，設定所需要溫度，開啟控制開關即可。

一般通電測試不過的原因，有以下幾點，僅供參考：

**1**、焊盤清理不好，虛焊；

**2**、錫漿回流溫度不到，虛焊；

**3**、加熱太快焊劑揮發太快，產生氣爆，造成晶片移位元、錫珠連接短路或錫珠缺位虛焊。**4**、焊接完的板子一定要先等冷卻後再清洗，不清洗或清洗後不乾燥，通電會燒壞板子的。

### 注意事項

**1**、工作完畢後，不要立即關電源，使風扇冷卻燈體。

**2**、保持通風口通風暢通，燈體潔淨。

**3**、導柱、調焦支架適時用油脂擦拭。

**4**、長久不使用，應拔去電源插頭。

**5**、小心，高溫操作，注意安全。

聲明：使用者使用說明書與實際產品之間不同的地方，以實際產品為準！